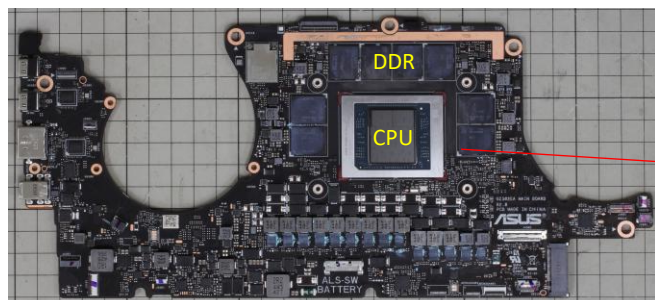
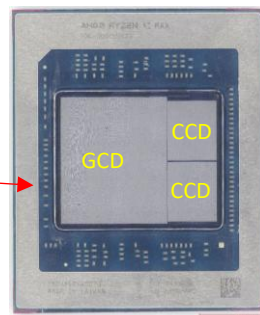


Chiplet : ASUS ROG Flow Z13搭載AMD Ryzen AI MAXパッケージ 分解、断面構造解析 & 平面解析レポート



ASUS ROG FLOW メイン基板



パッケージ外観

レポート概要

AMD Ryzen AI MAX 390は、次世代のノートPC向けプロセッサで、AI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）を搭載し、最大50 TOPSのAI性能を発揮します。Zen 5 CPUコアとRDNA 3.5 GPUを採用し、高性能と省電力を両立。AI対応アプリや生成AI処理に最適です。

パッケージはFC-BGA(FP11ソケット)を採用し、ボールグリッドアレイ式で約2077ピン構成です。1個のGraphics Compute Die(GCD)と2個のCore Complex Die(CCD)を搭載しており10層基板で構成されています。

今回、パッケージ構造と配線に着目し下記3つのレポートをリリースしました。

解析内容 レポート価格

1. ASUS ROG Flow Z13分解レポート (500,000円) 発注後1weekで納品

- 分解工程
- メイン基板搭載部品調査
- AMD RyzenプロセッサとDDR間の配線情報（各層(14層)の線幅、線ピッチ）、および電源、GNDの配線情報（各層(14層)の線幅、線ピッチ）

2. AMD Ryzen AI MAX 390断面構造解析レポート(350,000円) 発注後1weekで納品

- パッケージX線写真
- 断面構造
- 各層厚さ測定

3. AMD Ryzen AI MAX 390平面解析レポート(500,000円) 発注後1weekで納品

- 各配線情報（各層(10層)の写真、線幅、線ピッチ）

目次

1. ASUS ROG Flow Z13分解レポート (38 pages)

I. Product outline	3
II. Teardown	5
III. Overview of PCB	9
IV. X-Ray of PCB	12
V. Package (Ruden AI MAX)	14
VI. X-Ray of Package	16
VII. Key semiconductor of PCB	17
VIII. Capacitor of Package	19
IX. LRC part list of PCB	20

2. AMD Ryzen AI MAX 390断面構造解析レポート (16 pages)

I. Product outline	2
II. Analysis summary	3
III. Cross section	5

3. AMD Ryzen AI MAX 390平面解析レポート (40 pages)

I. Product image	2
II. PCB image (Top and Bottom)	3
III. Line and Space (CPU-Memory) of each 10 layers	5
IV. Line and Space (Power and GND) each 10 layers	15
V. Package image (Top and Bottom)	34
VI. Line and Space of each 4 layers	35